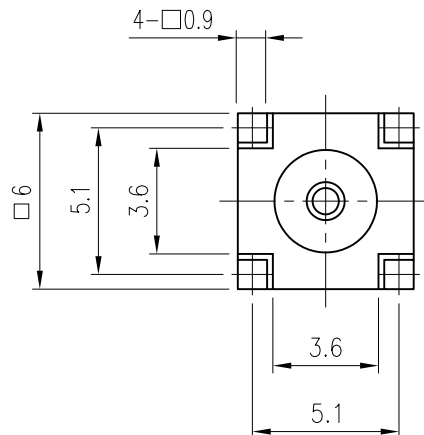
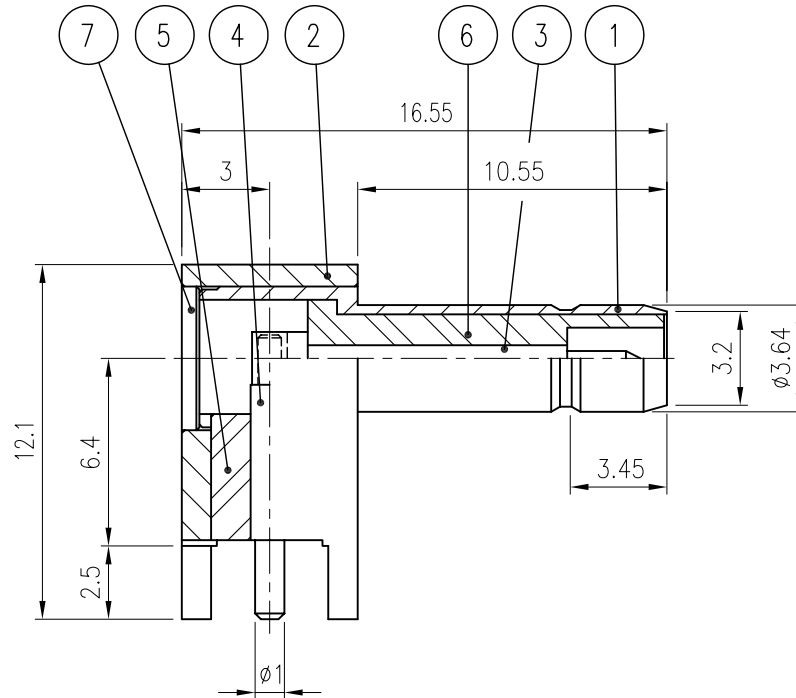


ST	기	정	수	정	내	용	수 정 내 용				
							부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)							1	조립방법변경 (납땜->역지끼움)	최충락	김기영	2002년 3월 19일
ST(개선)											



7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO0024-15/1 (L1005)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00282-N/1 (H3108)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00303-N/1 (H3100)
4	CONTACT (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00347-15/1 (E3110)
3	CONTACT (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00390-135/1 (E3109)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00468-135/1 (D3105B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00476-135/1 (D3105A)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2002. 2. 19.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMB-LR-PC		
	승인						
재질	감도				도명		
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번	CN00214-7/1
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량				K315-670-002